



# X線回折ラミノグラフィー測定系の構築VI

藤榮 文博<sup>1</sup>, 花田 賢志<sup>2</sup> 1 電力中央研究所, 2 あいちシンクロトロン光センター

キーワード:X線回折ラミノグラフィー、結晶欠陥、3次元評価

## 1. 背景と研究目的

X線トポグラフィーは単結晶材料内部の格子欠陥を非破壊で評価する手法として、半導体材料のみならず有機結晶、タンパク質を対象として広く用いられている。一般的に利用される X線トポグラフィーは、X線照射領域の回折 X線の方向への 2 次元投影像であるが、3 次元像を得る手法として、上下幅を制限したシート状の X 線を照射し試料を走査するステップスキャニングセクショントポグラフィーや、回折ベクトル g を回転軸として試料を回転させることで得られる二次元投影像を画像再構成するトポートモグラフィーがある。近年、平板形状のシリコン単結晶について、透過ラウエ配置のみならず後方反射配置で転位の 3 次元観察を試みた例が報告されている[1]。この手法は、トポートモグラフィーと同様の原理ではあるが平板試料に対して適用されており X 線回折ラミノグラフィーと呼称されている。今回は、パワーデバイス用材料として期待される炭化ケイ素(SiC)単結晶を対象として、転位の 3 次元観察を目的に X 線回折ラミノグラフィー測定系の構築を試みた。

#### 2. 実験内容

X線回折ラミノグラフィー実験はビームラインBL8S2にて実施した。Si(111)二結晶モノクロメーターにより単色化し、透過配置にて回折像をフラットパネルセンサー、およびCMOSカメラにて検出した。 測定試料には4H-SiC単結晶を用いた。

## 3. 結果および考察

サイズの異なる SiC 単結晶試料について、試料回転中に回折光を連続検出できるように試料方位の調整を行った。概ね回折ベクトルと回転軸が平行になるように試料方位を調整したものの、試料のドリフトにより回折条件を満たす領域がずれる場合があったため、ドリフトを抑える試料の固定方法を検討した。

## 4. 参考文献

1. D. Hänschke, L. Helfen, V. Altapova, A. Danilewsky, and T. Baumbach, Applied Physics Letters **101**, 244103 (2012).